

Fiche de procédure

Informations de base	
DEA - Procédure d'acte délégué 2013/2905(DEA)	Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur
<p>Exemption pour le plomb dans les soudures sur les cartes de circuits imprimés, les revêtements des extrémités des composants électriques et électroniques et les revêtements des cartes de circuits imprimés, les soudures de raccordement des fils et des câbles et les soudures de raccordement des transducteurs et des capteurs qui sont utilisés durablement à une température inférieure à ? 20 °C</p> <p>Complétant 2008/0240(COD)</p> <p>Sujet 3.40.06 Industries électronique, électrotechnique, TIC, robotique 3.70.13 Substances dangereuses, déchets toxiques et radioactifs (stockage, transport)</p>	

Portail de documentation				
Document de base non législatif		C(2013)06798	18/10/2013	EC